

2014-2020年中国印制电路板市场监测及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2020年中国印制电路板市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1405/501285ABGH.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-05-13

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2020年中国印制电路板市场监测及投资前景研究报告》共十章。首先介绍了印制电路板相关概述、中国印制电路板市场运行环境等，接着分析了中国印制电路板市场发展的现状，然后介绍了中国印制电路板重点区域市场运行形势。随后，报告对中国印制电路板重点企业经营状况分析，最后分析了中国印制电路板行业发展趋势与投资预测。您若想对印制电路板产业有个系统的了解或者想投资印制电路板行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

2013年中国PCB产业也处于调整时期。中国大陆企业产品类别众多，在智能产品领域中的HDI、高端FPC、特种板等类型企业相对发展稳健；低端消费类电子及电脑类PCB生产企业因需求降低而利润微薄。另外，企业管理水平、市场能力、成本控制、资金安全与融资渠道等在竞争激烈情况下差异化更加明显。

2013年中国PCB产业在经历2012年的调整之后将恢复增长，技术、管理提升、新扩产能等将推动中国PCB产业继续保持发展，进一步扩大在国际市场的份额与影响力。

中国PCB产业通过整合和转型，企业分化步伐将加快，一批优良的规模企业将推动中国PCB产业继续做大做强。从2000年到2015年中国PCB产业发展趋势预测来看，中国印制电路产业将继续保持发展的势头。这主要得益于规模企业继续加大投资，以江西、湖北、重庆、江苏北部为代表的电子电路产业园的产业转移和集聚发展，以及国内一批优秀企业通过管理提升、建立适应新经济形势的人力资源、效益分配机制等新型企业经济文化，促使一批优秀企业在企业规模、技术水平、管理水平、市场拓展等方面获得持续发展，推动中国PCB产业向更高技术含量产品和技术、更成熟配套系统、更均衡的国内国际市场份额发展，使中国PCB产业更为成熟和强大。

从产品产量发展趋势来看，产量增长幅度将放缓，主要是传统低端产品产量需求将保持在一定数量上，电脑和传统办公等电子产品逐步被体积更小、功能更强的高端智能产品所替代。HDI积层板尤其是任意层连接ALIVH (Any Layer Inner Via Hole) HDI板、IC载板、多层FPC板、软硬结合板等方面将是发展的主力。

第一章 印制电路板（PCB）的相关概述

1.1 PCB的介绍

1.1.1 PCB的定义

1.1.2 PCB的分类

1.1.3 PCB的历史

1.2 PCB的产业链

1.2.1 PCB产业链的构成

1.2.2 产业链中的产品介绍

第二章 2011-2013年国际PCB产业发展分析

2.1 2010-2013年全球PCB产业发展概况

2.1.1 国际重点PCB制造企业的概述

2.1.2 2010年全球PCB工业发展回顾

2.1.3 2011年全球PCB行业发展状况

2.1.4 2012-2013年全球PCB产业发展综述

2.1.5 国外印制电路板制造技术的发展

2.2 美国

2.2.1 美国PCB产业的发展概况

2.2.2 美国PCB主要生产厂家的发展

2.2.3 北美PCB产业发展现状

2.3 欧洲

2.3.1 欧洲PCB产业发展概况

2.3.2 2011年欧洲PCB行业发展开始恢复

2.3.3 2012-2013年德国PCB产业的发展

2.4 日本

2.4.1 日本PCB产业的发展阶段

2.4.2 日本PCB产业的业发展回顾

2.4.3 2012-2013年日本PCB产业的发展

2.4.4 日本领先PCB厂商发展高端路线

2.5 台湾地区

2.5.1 2011年台湾PCB产业的发展

2.5.2 2012-2013年台湾PCB产业的发展

2.5.3 台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

第三章 2011-2013年中国PCB产业发展分析

3.1 2011-2013年我国PCB产业的发展概况

3.1.1 我国PCB产业的产值及产能

- 3.1.2 我国PCB产业的产品结构
- 3.1.3 我国PCB行业配套日渐完善
- 3.1.4 我国成全球最大PCB制造基地
- 3.1.5 我国PCB产业的发展机遇
- 3.2 PCB产业竞争力分析
 - 3.2.1 竞争对手
 - 3.2.2 替代品
 - 3.2.3 潜在进入者
 - 3.2.4 供应商的力量
- 3.3 HDI市场发展分析
 - 3.3.1 HDI市场容量
 - 3.3.2 HDI市场供求
 - 3.3.3 HDI市场趋势
- 3.4 我国PCB产业发展问题及对策
 - 3.4.1 我国PCB产业与国外存在的差距
 - 3.4.2 PCB产业发展面临的挑战
 - 3.4.3 PCB产业持续发展的措施
 - 3.4.4 PCB产业需发展民族品牌

第四章 中国印制电路板制造业财务状况

- 4.1 中国印制电路板制造业经济规模
 - 4.1.1 2009-2013年印制电路板制造业销售规模
 - 4.1.2 2009-2013年印制电路板制造业利润规模
 - 4.1.3 2009-2013年印制电路板制造业资产规模
- 4.2 中国印制电路板制造业盈利能力指标分析
 - 4.2.1 2009-2013年印制电路板制造业亏损面
 - 4.2.2 2009-2013年印制电路板制造业销售毛利率
 - 4.2.3 2009-2013年印制电路板制造业成本费用利润率
 - 4.2.4 2009-2013年印制电路板制造业销售利润率
- 4.3 中国印制电路板制造业营运能力指标分析
 - 4.3.1 2009-2013年印制电路板制造业应收账款周转率
 - 4.3.2 2009-2013年印制电路板制造业流动资产周转率

- 4.3.3 2009-2013年印制电路板制造业总资产周转率
- 4.4 中国印制电路板制造业偿债能力指标分析
 - 4.4.1 2009-2013年印制电路板制造业资产负债率
 - 4.4.2 2010-2013年12月印制电路板制造业利息保障倍数
- 4.5 中国印制电路板制造业财务状况综合分析
 - 4.5.1 印制电路板制造业财务状况综合评价
 - 4.5.2 影响印制电路板制造业财务状况的经济因素分析

第五章 2011-2013年PCB制造技术的研究

- 5.1 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述
 - 5.1.1 PCB芯片封装的介绍
 - 5.1.2 PCB芯片封装的主要焊接方法
 - 5.1.3 PCB芯片封装的流程
- 5.2 光电PCB技术
 - 5.2.1 光电PCB的概述
 - 5.2.2 光电PCB的光互连结构原理
 - 5.2.3 光学PCB的优点
 - 5.2.4 光电PCB的发展阶段
- 5.3 PCB技术的发展趋势
 - 5.3.1 向高密度互连技术方向发展
 - 5.3.2 组件埋嵌技术的发展
 - 5.3.3 材料开发的提升
 - 5.3.4 光电PCB的前景广阔
 - 5.3.5 先进设备的引入

第六章 2011-2013年PCB上游原材料市场分析

- 6.1 铜箔
 - 6.1.1 铜箔的相关概述
 - 6.1.2 铜箔在柔性印制电路中的应用
 - 6.1.3 电解铜箔产业的发展概况
- 6.2 环氧树脂
 - 6.2.1 环氧树脂的相关概述

- 6.2.2 环氧树脂的主要应用领域
- 6.2.3 我国环氧树脂产业的发展现状

6.3 玻璃纤维

- 6.3.1 玻璃纤维的相关概述
- 6.3.2 我国成为全球最大玻璃纤维生产国
- 6.3.3 2011年我国玻璃纤维行业发展状况
- 6.3.4 2012年玻璃纤维产业运行分析
- 6.3.5 2013年玻璃纤维产业运行分析

第七章 2011-2013年PCB下游应用领域分析

7.1 消费类电子产品

- 7.1.1 2011年我国消费电子产品发展综述
- 7.1.2 2012年我国消费电子产品市场发展状况
- 7.1.3 2013年我国消费电子产品市场发展状况
- 7.1.4 消费电子用PCB市场需求稳定增长
- 7.1.5 高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

7.2 通讯设备

- 7.2.1 2011年我国通讯设备制造业发展
- 7.2.2 2012年我国通信设备业的发展
- 7.2.3 2013年我国通信设备业的发展
- 7.2.4 语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

7.3 汽车电子

- 7.3.1 PCB成为汽车电子市场的热点
- 7.3.2 多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大
- 7.3.3 2012年全球汽车电子PCB市场发展预测

7.4 LED照明

- 7.4.1 中国LED照明的发展状况
- 7.4.2 LED发展为PCB行业带来新需求

第八章 国外重点PCB制造商介绍

8.1 日本企业

- 8.1.1 日本揖斐电株式会社(IBIDEN)

8.1.2 日本旗胜 (Nippon Mektron)

8.1.3 日本CMK公司

8.2 美国企业

8.2.1 MULTEK

8.2.2 美国TTM

8.2.3 新美亚 (SANMINA-SCI)

8.2.4 惠亚集团 (Viasystems)

8.3 韩国企业

8.3.1 三星电机 (Samsung E-M)

8.3.2 永丰 (Young Poong Group)

8.3.3 LG Electronics

8.4 台湾企业

8.4.1 欣兴电子

8.4.2 健鼎科技

8.4.3 雅新电子

第九章 2011-2013年国内PCB上市公司经营状况

9.1 沪电股份

9.1.1 公司简介

9.1.2 2011年1-12月沪电股份经营状况分析

9.1.3 2012年1-12月沪电股份经营状况分析

9.1.4 2013年1-12月沪电股份经营状况分析

9.2 天津普林

9.2.1 公司简介

9.2.2 2011年1-12月天津普林经营状况分析

9.2.3 2012年1-12月天津普林经营状况分析

9.2.4 2013年1-12月天津普林经营状况分析

9.3 生益科技

9.3.1 公司简介

9.3.2 2011年1-12月生益科技经营状况分析

9.3.3 2012年1-12月生益科技经营状况分析

9.3.4 2013年1-12月生益科技经营状况分析

- 9.4 超声电子
 - 9.4.1 公司简介
 - 9.4.2 2011年1-12月超声电子经营状况分析
 - 9.4.3 2012年1-12月超声电子经营状况分析
 - 9.4.4 2013年1-12月超声电子经营状况分析
- 9.5 超华科技
 - 9.5.1 公司简介
 - 9.5.2 2011年1-12月超华科技经营状况分析
 - 9.5.3 2012年1-12月超华科技经营状况分析
 - 9.5.4 2013年1-12月超华科技经营状况分析
- 9.6 上市公司财务比较分析
 - 9.6.1 盈利能力分析
 - 9.6.2 成长能力分析
 - 9.6.3 营运能力分析
 - 9.6.4 偿债能力分析

第十章 PCB行业投资分析及前景预测

- 10.1 PCB投资分析
 - 10.1.1 PCB行业SWOT分析
 - 10.1.2 PCB投资面临的风险
 - 10.1.3 PCB市场投资空间大
- 10.2 PCB产业发展前景预测
 - 10.2.1 2015年国际PCB行业发展预测
 - 10.2.3 未来我国PCB行业将保持高速增长
 - 10.2.4 十二五期间我国PCB产业的发展重点
 - 10.2.5 2014-2020年我国印制电路板产业的发展前景预测

图表目录：

- 图表 各国家/地区PCB工厂数目
- 图表 全球不同种类PCB的增长率（按产品类型分）
- 图表 电子整机及PCB的应用领域和未来发展
- 图表 全球各国PCB产值

图表 电子工业（半导体）和PCB工业的增长

图表 全球各地区PCB产值分布

图表 全球主要手机PCB板厂家市场占有率

图表 全球PCB下游应用比例

图表 全球PCB产品结构

图表 美国PCB产值变化情况

图表 日本PCB产量统计表

图表 日本PCB厂家海外产值（按产品类型分类）

图表 日本PCB厂家海外产值（按国家分类）

图表 日本PCB进出口量（按国别统计）

图表 日本PCB出口量（按地区统计）

图表 日本印制电路板设备投资额

图表 台湾PCB的资本构成

图表 台湾不同种类PCB的比例

图表 台湾PCB市场规模

图表 中国PCB产业主要本土企业销售收入增长幅度

图表 2009-2013年印制电路板制造业销售销售收入

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售销售收入增长趋势图

图表 2010-2013年12月印制电路板制造业销售不同规模企业销售额

图表 2012年1-12月印制电路板制造业销售不同规模企业销售额对比图

图表 2013年1-12月印制电路板制造业销售不同规模企业销售额

图表 2013年1-12月印制电路板制造业销售不同规模企业销售额对比图

图表 2010-2013年12月印制电路板制造业销售不同所有制企业销售额

图表 2012年1-12月印制电路板制造业销售不同所有制企业销售额对比图

图表 2013年1-12月印制电路板制造业销售不同所有制企业销售额

图表 2013年1-12月印制电路板制造业销售不同所有制企业销售额对比图

图表 2009-2013年印制电路板制造业销售利润总额

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售利润总额增长趋势图

图表 2010-2013年12月印制电路板制造业销售不同规模企业利润总额

图表 2012年1-12月印制电路板制造业销售不同规模企业利润总额对比图

图表 2013年1-12月印制电路板制造业销售不同规模企业利润总额

图表 2013年1-12月印制电路板制造业销售不同规模企业利润总额对比图

图表 2010-2013年12月印制电路板制造业销售不同所有制企业利润总额

图表 2013年1-12月印制电路板制造业销售不同所有制企业利润总额

图表 2013年1-12月印制电路板制造业销售不同所有制企业利润总额对比图

图表 2009-2013年印制电路板制造业销售资产总额

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售总资产增长趋势图

图表 截至2013年12月底印制电路板制造业销售不同规模企业总资产

图表 截至2013年12月底印制电路板制造业销售不同规模企业总资产对比图

图表 截至2013年12月底印制电路板制造业销售不同所有制企业总资产

图表 截至2013年12月底印制电路板制造业销售不同所有制企业总资产对比图

图表 2009-2013年印制电路板制造业销售亏损面

图表 2009-2013年印制电路板制造业销售亏损企业亏损总额

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售销售毛利率趋势图

图表 2009-2013年1-12月印制电路板制造业销售成本费用率

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售成本费用利润率趋势图

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售销售利润率趋势图

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售应收账款周转率对比图

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售流动资产周转率对比图

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售总资产周转率对比图

图表 2009-2012年印制电路板制造业销售资产负债率对比图

图表 2010-2013年12月印制电路板制造业销售利息保障倍数对比图

图表 光学PCB和传统PCB的优点对比

图表 压延退火方法制造的铜箔产品

图表 铜箔的分类

图表 电解铜箔制造过程示意图

图表 铜箔的处理阶段和稳定性

图表 环氧树脂胶粘剂的主要用途

图表 2009-2010年华东环氧树脂市场走势图

图表 全国玻璃纤维纱累计产量

图表 玻纤及制品主要进口来源地

图表 玻璃纤维及制品出口量

图表 通信设备制造业工业销售情况

图表 我国通信设备产品产量及增长

图表 我国通讯设备主要出口产品增长情况

图表 我国通讯设备主要进口产品增长情况

图表 通信设备制造业、计算机及其他电子设备制造业投资情况

图表 通信设备制造业不同所有制企业经营情况

图表 通信设备制造业不同规模企业经营情况

图表 全球手机销售量与Smart Phone市场渗透率

图表 国内LED产量、芯片产量及芯片国产率

图表 我国LED市场规模及增长率变化

图表 我国LED封装产量变化

图表 我国半导体照明应用领域

图表 国内外功率型白光LED技术指标对比

图表 2011年1-12月沪电股份非经常性损益项目及金额

图表 2010-2013年沪电股份主要会计数据

图表 2010-2013年沪电股份主要财务指标

图表 2011年1-12月沪电股份主营业务分行业、产品情况

图表 2011年1-12月沪电股份主营业务分地区情况

图表 2012年1-12月沪电股份非经常性损益项目及金额

图表 2010年-2012年沪电股份主要会计数据

图表 2010年-2012年沪电股份主要财务指标

图表 2012年1-12月沪电股份主营业务分行业、产品情况

图表 2012年1-12月沪电股份主营业务分地区情况

图表 2013年1-12月沪电股份主要会计数据及财务指标

图表 2013年1-12月沪电股份非经常性损益项目及金额

图表 2011年1-12月天津普林非经常性损益项目及金额

图表 2010-2013年天津普林主要会计数据

图表 2010-2013年天津普林主要财务指标

图表 2011年1-12月天津普林主营业务分行业、产品情况

图表 2011年1-12月天津普林主营业务分地区情况

图表 2012年1-12月天津普林非经常性损益项目及金额

图表 2010年-2012年天津普林主要会计数据

图表 2010年-2012年天津普林主要财务指标

图表 2012年1-12月天津普林主营业务分行业、产品情况

图表 2012年1-12月天津普林主营业务分地区情况

图表 2013年1-12月天津普林主要会计数据及财务指标

图表 2013年1-12月天津普林非经常性损益项目及金额

图表 2011年1-12月生益科技非经常性损益项目及金额

图表 2010-2013年生益科技主要会计数据

图表 2010-2013年生益科技主要财务指标

图表 2011年1-12月生益科技主营业务分行业、产品情况

图表 2011年1-12月生益科技主营业务分地区情况

图表 2012年1-12月生益科技非经常性损益项目及金额

图表 2010年-2012年生益科技主要会计数据

图表 2010年-2012年生益科技主要财务指标

图表 2012年1-12月生益科技主营业务分行业、产品情况

图表 2012年1-12月生益科技主营业务分地区情况

图表 2013年1-12月生益科技主要会计数据及财务指标

图表 2013年1-12月生益科技非经常性损益项目及金额

图表 2011年1-12月超声电子非经常性损益项目及金额

图表 2010-2013年超声电子主要会计数据

图表 2010-2013年超声电子主要财务指标

图表 2011年1-12月超声电子主营业务分行业、产品情况

图表 2011年1-12月超声电子主营业务分地区情况

图表 2012年1-12月超声电子非经常性损益项目及金额

图表 2010年-2012年超声电子主要会计数据

图表 2010年-2012年超声电子主要财务指标

图表 2012年1-12月超声电子主营业务分行业、产品情况

图表 2012年1-12月超声电子主营业务分地区情况

图表 2013年1-12月超声电子主要会计数据及财务指标

图表 2013年1-12月超声电子非经常性损益项目及金额

图表 2011年1-12月超华科技非经常性损益项目及金额

图表 2010-2013年超华科技主要会计数据

图表 2010-2013年超华科技主要财务指标

图表 2011年1-12月超华科技主营业务分行业、产品情况

图表 2011年1-12月超华科技主营业务分地区情况

图表 2012年1-12月超华科技非经常性损益项目及金额

图表 2010年-2012年超华科技主要会计数据

图表 2010年-2012年超华科技主要财务指标

图表 2012年1-12月超华科技主营业务分行业、产品情况

图表 2012年1-12月超华科技主营业务分地区情况

图表 2013年1-12月超华科技主要会计数据及财务指标

图表 2013年1-12月超华科技非经常性损益项目及金额

图表 2013年印制电路板行业上市公司盈利能力指标分析

图表 2011年印制电路板行业上市公司盈利能力指标分析

图表 2010年印制电路板行业上市公司盈利能力指标分析

图表 2013年印制电路板行业上市公司成长能力指标分析

图表 2012年印制电路板行业上市公司成长能力指标分析

图表 2011年印制电路板行业上市公司成长能力指标分析

图表 2013年印制电路板行业上市公司营运能力指标分析

图表 2012年印制电路板行业上市公司营运能力指标分析

图表 2011年印制电路板行业上市公司营运能力指标分析

图表 2013年印制电路板行业上市公司偿债能力指标分析

图表 2012年印制电路板行业上市公司偿债能力指标分析

图表 2011年印制电路板行业上市公司偿债能力指标分析

图表 2014-2020年中国印制电路板行业销售收入预测

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1405/501285ABGH.html>